

2021-2027年中国集成电路 市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2021-2027年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/P743809LGT.html>

【报告价格】纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8200元

【出版日期】2020-11-11

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2021-2027年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》介绍了集成电路行业相关概述、中国集成电路产业运行环境、分析了中国集成电路行业的现状、中国集成电路行业竞争格局、对中国集成电路行业做了重点企业经营状况分析及中国集成电路产业发展前景与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特·诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。

我国集成电路产业产品的供给水平和产业技术水平有了一定提高，但相对于国内巨大的市场，供需矛盾变得日益突出。2019年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%；进口金额3120.6美元，同比增长19.8%。出口集成电路2171亿块，同比增长6.2%；出口金额846.4亿美元，同比增长26.6%。

据博思数据发布的《2021-2027年中国集成电路市场分析与投资前景研究报告》表明：2020年我国集成电路产量累计值达2612.6亿块，期末产量比上年累计增长16.2%。

| 指标 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 | 集成电路产量 |
|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| 当期值(亿块) | 276 | 252.1 | 272.9 | 240.5 | 222.2 | 222 | 集成电路产量累计值(亿块) |
| | 2612.6 | 2339 | 2113.9 | 1821.8 | 1587.9 | 1389.5 | 集成电路产量同比增长(%) |
| | 20.8 | 19.6 | 20.4 | 16.4 | 12.1 | 9 | 集成电路产量累计增长(%) |
| | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 14.7 | 14.6 | 12.7 | |

报告目录：

第一章 集成电路基本情况

1.1 集成电路的相关介绍

1.1.1 集成电路概念

1.1.2 集成电路行业

1.2 集成电路产品流程及产业链结构

1.2.1 集成电路产品流程

1.2.2 集成电路产业链结构

第二章 2015-2019年集成电路发展环境分析

2.1 宏观经济环境

2.1.1 全球经济发展形势

2.1.2 中国宏观经济概况

2.1.3 中国工业运行情况

2.1.4 中国经济发展展望

2.2 政策环境分析

2.2.1 产业相关政策汇总

2.2.2 企业免税政策分析

2.2.3 产业的国家投资前景

2.2.4 “十三五”发展规划

2.3 产业发展环境

2.3.1 电子信息产业与集成电路

2.3.2 智能化带动集成电路发展

2.3.3 区块链发展带来产业新增量

第三章 2015-2019年半导体所属行业发展分析

3.1 2015-2019年全球半导体行业调研

3.1.1 半导体市场发展规模

3.1.2 半导体产业区域分析

3.1.3 半导体产品结构分析

3.1.4 半导体与集成电路

3.2 2015-2019年中国半导体行业调研

3.2.1 产业发展态势

3.2.2 产业规模现状

3.2.3 市场发展动力

3.2.4 产业发展趋势

3.3 2015-2019年半导体材料所属行业调研

3.3.1 半导体材料的重要意义

3.3.2 半导体材料行业的特点

- 3.3.3 全球半导体材料市场
- 3.3.4 中国半导体材料市场
- 3.3.5 中国半导体材料国产化
- 3.3.6 半导体材料与集成电路

第四章 2015-2019年全球集成电路所属产业发展分析

- 4.1 全球集成电路产业分析
 - 4.1.1 全球销售规模分析
 - 4.1.2 全球产品结构分析
 - 4.1.3 全球细分市场规模
- 4.2 美国集成电路产业分析
 - 4.2.1 产业发展概况
 - 4.2.2 产业发展模式
 - 4.2.3 产业技术计划
- 4.3 台湾集成电路产业分析
 - 4.3.1 产业发展基本情况
 - 4.3.2 IC设计业发展现状
 - 4.3.3 晶圆代工业发展现状
 - 4.3.4 封装测试业发展现状
- 4.4 其他国家集成电路产业分析
 - 4.4.1 韩国集成电路产业概况
 - 4.4.2 日本集成电路产业分析

第五章 2015-2019年中国集成电路所属产业发展分析

- 5.1 集成电路产业发展综述
 - 5.1.1 产业发展历程
 - 5.1.2 产业发展意义
- 5.2 集成电路所属产业运行规模分析
 - 5.2.1 市场销售规模
 - 5.2.2 进口规模分析
 - 5.2.3 出口规模分析
 - 5.2.4 产业结构分析

5.3 集成电路市场竞争分析

5.3.1 行业进入壁垒的提高

5.3.2 上游行业垄断程度高

5.3.3 行业内竞争持续加剧

5.3.4 企业盈利能力增强

5.3.5 研发投入持续增长

5.4 集成电路产业发展问题及投资策略

5.4.1 产业发展问题

5.4.2 产业投资策略

5.5 集成电路产业核心竞争力提升方法

5.5.1 提高扶持资金集中运用率

5.5.2 制定融资投资制度

5.5.3 提高政府采购力度

5.5.4 建立技术中介服务制度

5.5.5 人才引进与人才培养

第六章 2015-2019年中国集成电路主要城市分析

6.1 北京

6.1.1 产业发展现状

6.1.2 产业市场规模

6.1.3 产业发展特点

6.1.4 产业发展瓶颈

6.1.5 产业发展对策

6.2 上海

6.2.1 产业发展规模

6.2.2 产业发展预测

6.2.3 技术发展预测

6.2.4 产业发展思路

6.2.5 发展措施及建议

6.3 深圳

6.3.1 产业政策环境

6.3.2 产业发展现状

- 6.3.3 产业发展规模
- 6.3.4 产业发展目标
- 6.3.5 产业发展动态
- 6.4 杭州
 - 6.4.1 产业发展背景
 - 6.4.2 行业发展现状
 - 6.4.3 行业发展问题
 - 6.4.4 发展对策建议
- 6.5 厦门
 - 6.5.1 产业发展政策
 - 6.5.2 产业发展规模
 - 6.5.3 产业优劣势分析
 - 6.5.4 产业发展建议
- 6.6 其他
 - 6.6.1 江苏
 - 6.6.2 湖南
 - 6.6.3 湖北武汉
 - 6.6.4 安徽合肥
 - 6.6.5 广东珠海

第七章 2015-2019年集成电路行业产品介绍

- 7.1 微处理器（MPU）
 - 7.1.1 CPU
 - 7.1.2 AP（APU）
 - 7.1.3 GPU
 - 7.1.4 MCU
 - 7.1.5 DSP
- 7.2 存储器
 - 7.2.1 存储器发展规模
 - 7.2.2 动态随机存取存储器（DRAM）
 - 7.2.3 存储器市场需求分析
 - 7.2.4 存储器市场份额划分

7.2.5 存储器在手机中的应用

7.3 NAND Flash (NAND闪存)

7.3.1 全球NAND Flash市场规模

7.3.2 全球闪存的主要供应厂商

7.3.3 全球闪存的技术发展

7.3.4 全球主要厂商表现

7.4 其他细分市场产品

7.4.1 存储芯片

7.4.2 逻辑芯片

7.4.3 处理芯片

7.4.4 模拟芯片

第八章 2015-2019年集成电路行业细分——集成电路设计业

8.1 集成电路设计介绍

8.2 集成电路设计业市场发展分析

8.2.1 行业销售规模

8.2.2 区域发展格局

8.2.3 主要城市分析

8.3 集成电路设计企业规模分析

8.3.1 设计企业规模

8.3.2 企业区域格局分析

8.3.3 企业从业人员规模

8.3.4 主要企业销售规模

8.3.5 各领域企业的规模

8.4 集成电路设计产业园区介绍

8.4.1 辽宁集成电路设计产业基地

8.4.2 北京中关村集成电路设计园

8.4.3 深圳集成电路设计应用产业园

第九章 2015-2019年集成电路行业核心——集成电路制造业

9.1 集成电路制造业发展情况分析

9.1.1 集成电路制造业基本概念

- 9.1.2 集成电路制造业增长原由
- 9.1.3 集成电路制造业重要性
- 9.1.4 集成电路制造业工艺技术
- 9.2 集成电路制造业发展规模分析
 - 9.2.1 市场发展规模分析
 - 9.2.2 主要企业销售规模
 - 9.2.3 市场投资建设规模
- 9.3 集成电路制造业发展问题分析
 - 9.3.1 市场份额较低
 - 9.3.2 产业化进程缓慢
 - 9.3.3 缺乏复合型人才
- 9.4 集成电路制造业发展思路及建议
 - 9.4.1 国家和地区设计有机结合
 - 9.4.2 坚持密切贴合产业链需求
 - 9.4.3 产业体系生态建设与完善
 - 9.4.4 依托相关政策推动国产化
 - 9.4.5 整合力量推动创新发展

第十章 2015-2019年集成电路行业细分——晶圆制造业

- 10.1 晶圆制造行业发展综述
 - 10.1.1 晶圆制造行业概述
 - 10.1.2 晶圆制造工艺分析
 - 10.1.3 晶圆加工技术介绍
- 10.2 全球晶圆制造业市场发展情况分析
 - 10.2.1 全球晶圆产能格局
 - 10.2.2 全球晶圆消费格局
 - 10.2.3 企业竞争情况分析
- 10.3 中国晶圆制造市场发展情况分析
 - 10.3.1 中国晶圆生产线规模
 - 10.3.2 中国晶圆设备的需求
 - 10.3.3 中国晶圆工厂的分布
- 10.4 晶圆制造行业发展趋势分析

- 10.4.1 全球市场发展趋势
- 10.4.2 全球市场发展预测
- 10.4.3 中国市场发展预测

第十一章 2015-2019年集成电路行业细分——封装测试业

- 11.1 集成电路封装测试行业发展综述
 - 11.1.1 封装测试业发展概况
 - 11.1.2 封装测试业的重要性
 - 11.1.3 封装测试行业竞争特征
- 11.2 中国集成电路封装测试市场发展分析
 - 11.2.1 市场发展态势分析
 - 11.2.2 市场发展规模分析
 - 11.2.3 主要企业收入规模
- 11.3 集成电路封装测试业技术发展分析
 - 11.3.1 技术最新发展情况
 - 11.3.2 未来产品的发展趋势
 - 11.3.3 存在的技术挑战
- 11.4 先进封装与系统集成创新平台
 - 11.4.1 中心基本情况
 - 11.4.2 中心基础建设
 - 11.4.3 中心服务状况
 - 11.4.4 中心创新机制
 - 11.4.5 中心专利成果

第十二章 2015-2019年集成电路其他相关行业调研

- 12.1 2015-2019年传感器行业调研
 - 12.1.1 行业发展基本态势
 - 12.1.2 全球行业发展规模
 - 12.1.3 全球市场竞争格局
 - 12.1.4 中国市场发展规模
 - 12.1.5 中国市场竞争格局
 - 12.1.6 行业投资预测

12.2 2015-2019年分立器件行业调研

12.2.1 行业的发展概况

12.2.2 行业的发展现状

12.2.3 分立器件市场规模

12.2.4 产业链上游分析

12.2.5 产业链下游分析

12.2.6 主要供应商分析

12.3 2015-2019年光电器件行业调研

12.3.1 行业政策环境

12.3.2 行业发展现状

12.3.3 行业产量规模

12.3.4 发展问题及挑战

12.3.5 行业投资策略

12.4 2015-2019年芯片行业发展分析

12.4.1 全球市场规模

12.4.2 中国产业规模

12.4.3 中国市场需求

12.4.4 产业发展困境

12.4.5 发展应对策略

12.5 2015-2019年硅片产业发展分析

12.5.1 硅片市场发展现状

12.5.2 硅片市场供需情况

12.5.3 硅片市场发展机遇

12.5.4 硅片与集成电路的关系

第十三章 2015-2019年集成电路技术分析

13.1 集成电路技术综述

13.1.1 技术联盟成立

13.1.2 技术应用分析

13.2 集成电路前道制造工艺技术

13.2.1 微细加工技术

13.2.2 电路互联技术

- 13.2.3 器件特性的退化
- 13.3 集成电路后道制造工艺技术
 - 13.3.1 3D集成技术
 - 13.3.2 晶圆级封装
- 13.4 集成电路的ESD防护技术
 - 13.4.1 集成电路的ESD现象成因
 - 13.4.2 集成电路ESD的防护器件
 - 13.4.3 基于SCR的防护技术分析
 - 13.4.4 集成电路全芯片的防护技术
- 13.5 集成电路技术发展趋势及前景展望
 - 13.5.1 技术发展趋势
 - 13.5.2 技术趋势预测
 - 13.5.3 技术市场展望

第十四章 2015-2019年集成电路应用市场发展分析

- 14.1 汽车工业
 - 14.1.1 汽车工业产销状况分析
- 2019年上半年汽车产量及同比增长

数据来源：公开资料整理

2019年上半年汽车销量及同比增长

数据来源：公开资料整理

- 14.1.2 汽车工业所属行业进出口状况分析
- 14.1.3 汽车工业经济效益分析
- 14.1.4 集成电路在汽车的应用状况
- 14.2 通信行业
 - 14.2.1 通信业总体情况
 - 14.2.2 通信业网络设施
 - 14.2.3 集成电路应用状况
- 14.3 消费电子
 - 14.3.1 消费电子市场发展状况

- 14.3.2 智能手机集成电路应用分析
- 14.3.3 电源管理IC市场调研
- 14.3.4 消费电子类集成电路技术分析
- 14.4 医学应用
 - 14.4.1 医学的应用概况
 - 14.4.2 便携式医疗仪器
 - 14.4.3 可穿戴式医疗仪器
 - 14.4.4 植入式医疗仪器
 - 14.4.5 仿生器官芯片
 - 14.4.6 医学应用发展趋势

第十五章 国外集成电路产业重点企业经营分析

- 15.1 英特尔 (Intel)
 - 15.1.1 企业发展概况
 - 15.1.2 企业经营状况分析
- 15.2 亚德诺 (ADI)
 - 15.2.1 企业发展概况
 - 15.2.2 企业经营状况分析
- 15.3 SK海力士 (SKhynix)
 - 15.3.1 企业发展概况
 - 15.3.2 企业经营状况分析
- 15.4 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)
 - 15.4.1 企业发展概况
 - 15.4.2 企业经营状况分析
- 15.5 德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS INC)
 - 15.5.1 企业发展概况
 - 15.5.2 企业经营状况分析
- 15.6 英飞凌 (Infineon Technologies AG)
 - 15.6.1 企业发展概况
 - 15.6.2 企业经营状况分析
- 15.7 意法半导体集团 (STMicroelectronics)
 - 15.7.1 企业发展概况

第十六章 中国集成电路产业重点企业经营分析

16.1 中芯国际集成电路制造有限公司

16.1.1 企业发展简况分析

16.1.2 企业经营情况分析

16.1.3 企业经营优劣势分析

16.2 杭州士兰微电子股份有限公司

16.2.1 企业发展简况分析

16.2.2 企业经营情况分析

16.2.3 企业经营优劣势分析

16.3 上海贝岭股份有限公司

16.3.1 企业发展简况分析

16.3.2 企业经营情况分析

16.3.3 企业经营优劣势分析

16.4 江苏长电科技股份有限公司

16.4.1 企业发展简况分析

16.4.2 企业经营情况分析

16.4.3 企业经营优劣势分析

16.5 吉林华微电子股份有限公司

16.5.1 企业发展简况分析

16.5.2 企业经营情况分析

16.5.3 企业经营优劣势分析

16.6 中电广通股份有限公司

16.6.1 企业发展简况分析

16.6.2 企业经营情况分析

16.6.3 企业经营优劣势分析

第十七章 2015-2019年集成电路产业投融资分析

17.1 集成电路产业投融资环境分析

17.1.1 产业固定资产投资规模

17.1.2 产业设立投资基金

17.1.3 产业项目建设情况

17.2 集成电路行业投资特性分析

17.2.1 周期性

17.2.2 区域性

17.2.3 特有模式

17.2.4 资金密集性

17.2.5 其他特性

17.3 集成电路产业投资基金分析

17.3.1 北京产业基金

17.3.2 上海产业基金

17.3.3 广东产业基金

17.3.4 陕西产业基金

17.3.5 其他区域基金

17.4 集成电路产业投资机遇分析

17.4.1 万物互联形成战略新需求

17.4.2 人工智能开辟技术新方向

17.4.3 协同开放构建研发新模式

17.4.4 新旧力量塑造竞争新格局

第十八章 2021-2027年集成电路产业发展趋势及趋势分析

18.1 集成电路产业发展趋势分析

18.1.1 产业投资前景布局

18.1.2 产业发展趋势变化

18.1.3 产业模式变化分析

18.2 集成电路产业趋势预测分析

18.2.1 全球市场发展预测

18.2.2 2021-2027年中国集成电路市场发展规模预测

部分图表目录：

图表 集成电路完整产品流程图

图表 集成电路完整产业链结构

图表 2015-2019年国内生产总值及其增长速度

图表 2015-2019年三次产业增加值占全国生产总值比重

图表 2015-2019年全部工业增加值及其增速

图表 中国集成电路行业主要政策汇总

图表 《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

图表 《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》发展目标

图表 2008-2019年全球半导体市场规模及增速

图表 2019年半导体销售额分地区占比

图表 2019年半导体分地区销售额增速

图表 2019年全球半导体产品结构

图表 2019年半导体市场分类增速

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/P743809LGT.html>